

## 科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號

聯絡人：郭天舜 科長

聯絡電話：02-2737-7285

傳真：

電子郵件：tskuo@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國107年3月13日

發文字號：科部工字第1070018269號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1、附件2、附件3、如說明四

主旨：本部工程司推動107年度「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫」，自即日起接受申請，請查照轉知。

說明：

一、本計畫申請及審查包含「構想書」及「計畫書」兩階段；申請人應於107年4月23日(星期一)前，將構想申請書電子檔E-mail至本部工程司聯絡人信箱；構想書獲審查推薦者，請申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提正式計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於107年6月22日(星期五)前函送本部，逾期不予受理。

二、本公告獲補助計畫需配合本部進行期中、期末成果追蹤、查核及考評，未獲補助案件恕不受理申覆。

三、本公告未盡事宜，應依本部補助專題研究計畫作業要點、本部補助專題研究計畫經費處理原則及其他相關法令規定辦理。

四、本專案計畫徵求公告如附件，計畫相關申請規範與研究範疇等請詳參公告內容。相關訊息另公布於本部網站(<http://www.most.gov.tw/>)-動態資訊(計畫徵求)或工程

司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項  
五、有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共304單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.183405】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2018-03-14 12:10, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2018-03-14 13:54, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2018-03-14 14:16, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2018-03-15 10:20, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 本計畫分2階段申請, 計畫構想書通過後, 始得提出計畫書申請。

二、意者請於107年4月23日(星期一)前將構想書電子檔E-mail至 msjiang@most.gov.tw, 構想書經科技部審查推薦後, 請於107年6月15日(星期五)中午12時前完成計畫書線上申請作業, 並致電研發處(分機2651)確認, 以利彙整辦理。

三、擬呈核後公告, 並另函轉知資訊及設計學院。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (待處理)